

令和7年12月8日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム
人・機械インタラクションWG
主査 武居 淳
副査 野村 健一、古志 知也

令和7年度 第6回 人・機械インタラクションWG (ロボット小WG) 開催のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より当コンソーシアムのワーキンググループ活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近年、労働人口の減少が顕著となり、新たな働き手としてロボットへの期待が高まっています。産業用ロボット、サービスロボット、コミュニケーションロボットなど、さまざまなロボットにセンシング技術を組み合わせることで、どのような新たな価値を創出できるかを議論するため、産総研内で医療ロボット、ならびにヒューマノイドとロボット基盤モデルを開発する研究者による講演を行います。

また、昨今注目されている「フィジカル AI」について、政府の公開情報等を踏まえ、その動向を追いかながら、センシングの立場からどのように共同研究や国プロ提案につなげていけるか、パネルディスカッションを通じてご参加の皆様と議論する場を設けたいと考えております。

本会終了後には会場近郊にて希望者による懇親会も企画しております。ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。

なお、前日の1月21日には、半導体製造センシング・実装技術 WG による展示会見学ツアーも予定しています。ぜひ併せてご参加をご検討ください。

敬具

記

日時：2026年1月22日（木） 14：30～17：20

場所：産業技術総合研究所柏センター 3F オープンスペース ならびに
オンライン開催 (Microsoft Teams)
※URLは参加申込の際に同時に送付されます。

内容：

14：30～14：40 開会の挨拶、WG活動の趣旨説明

14：40～15：20 講演「タイトル調整中（医療ロボット関連）」

研究戦略本部 セルフケア実装研究センター

遠隔セルフケア技術研究チーム 主任研究員 津村 遼介

15：20～16：00 講演「ヒューマノイドとロボット基盤モデルにおけるセンシング」

研究戦略本部 次世代ものづくり実装研究センター

ロボットソフトウェアPF研究チーム 主任研究員 室岡 雅樹

※各講演は質疑応答の時間を含みます。

16：00～16：10 休憩

16：10～17：10 パネルディスカッションならびに議論

「センシング技術とフィジカルAI」

※参考資料

経済産業省 AIロボティクス検討会 とりまとめ

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_robotsics/20251008_report.html

文部科学省 基礎研究振興部会(第16回) 配布資料

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu27/siryo/m_ext_00012.html

17：10～17：20 次回案内、事務連絡等

18：00～20：00 懇親会

※参加希望の有無は申込時のアンケートでお答えください。

会場は柏の葉キャンパス駅近郊を予定、決定次第ご連絡いたします。

以上

【今後の人・機械インタラクションWGの予定】

人・機械インタラクションWG総会

日時：2025/2月末～3月

場所：未定

内容：人・機械インタラクション技術に係る産総研技術の紹介

【開催場所へのアクセス】

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 柏センター

〒277-0882 千葉県柏市柏の葉6丁目2番3 東京大学柏IIキャンパス

アクセス：<https://www.aist.go.jp/kashiwa/ja/access/index.html>



【事務局】

国立研究開発法人産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム

人・機械インタラクションWG事務局

Email : M-stri-SenTePack-hint-ml@aist.go.jp

※現在参加者募集中